

財政統計通報

(第 15 號)



財政部統計處

113 年 8 月 15 日

撰稿人：李震宇研究員

聯絡人：殷英洳科長

聯絡電話：(02)23228341

我國生產半導體等機械出口 10 年來成長 2.6 倍，今年 1-7 月占機械總出口已突破 2 成

1. 近年來受到全球經濟成長起伏，地緣政治風險與關稅、匯率干擾，及鄰近國家競爭影響，加以國內電子資通產品外銷高速擴張之排擠，我國機械出口占總出口比重由民國 102 年之 6.8% 下滑至 112 年之 5.6%，其中以往居主力地位的金屬加工工具機出口值由 36 億美元降至 26 億美元，占機械出口比重由 16.9% 劇減為 10.7%，反觀生產半導體等機械則隨國內半導體產業鏈崛起，112 年出口值 48 億美元較 102 年增加 2.6 倍，今(113)年 1-7 月占機械出口比重首度突破 2 成，為最大品項，並較 102 年(6.4%)上升 14.2 個百分點。

我國機械出口概況

單位：億美元；%

貨品別		102年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年 1-7月
		機械出口	金額 209.9	238.4	255.7	235.0	219.2	278.3	285.5	242.1
	占比*	6.8	7.6	7.7	7.1	6.4	6.2	6.0	5.6	5.1
生產半導體等機械	金額	13.3	28.1	31.3	32.2	35.2	48.3	50.7	47.6	28.1
	占比*	6.4	11.8	12.3	13.7	16.1	17.4	17.8	19.7	20.6
	年增率	18.7	62.7	11.5	2.9	9.3	37.2	4.9	-6.1	6.9
金屬加工工具機	金額	35.6	33.4	36.6	30.7	21.5	27.8	30.2	26.0	12.5
	占比*	16.9	14.0	14.3	13.0	9.8	10.0	10.6	10.7	9.2
	年增率	-16.6	15.3	9.5	-16.1	-29.7	29.2	8.6	-14.0	-17.2

附註：*分別指機械占總出口比重，生產半導體等機械、金屬加工工具機占機械出口之比重。

2. 隨美中貿易戰延伸至科技戰，加上各國競相投入半導體產業發展，帶動相關製造設備之貿易疾速成長。2023 年全球生產半導體等機械出口高達 200 億美元之國家依序為日本、荷蘭、新加坡及美國，且 6~8 成的外銷市場均集中於東亞之中國大陸、中華民國及南韓；其中日本出口長期保持領先，荷蘭因極紫外光及深紫外光曝光機熱銷，僅以 4 億美元之些微差距進逼日本。2023 年全球前 3 大進口地區為中國大陸、中華民國及南韓，中國大陸為推動半導體自主，積極大量進口晶片製造設備，近 6 年進口金額多超過 300 億美元，穩居首席，我國因持續開發高階新製程以保持技術領先，並擴大產能搶占市場份額，進口 196 億美元居次，南韓則因記憶體價格崩跌，投資步伐放緩，居第 3。

2023 年生產半導體等機械主要出/進口地區之相關統計

單位：億美元；%

世界排名	出口				進口			
	1	2	3	4	1	2	3	
出進口值	日本 252	荷蘭 248	新加坡 216	美國 201	中國大陸 396	中華民國 196	南韓 173	
出進口市場比重	1	中國大陸 42.9	中國大陸 27.4	中國大陸 36.0	南韓 22.3	日本 28.9	荷蘭 28.8	荷蘭 31.2
	2	中華民國 16.5	南韓 27.2	中華民國 15.6	中國大陸 21.9	荷蘭 19.0	日本 20.4	美國 22.4
	3	南韓 15.0	中華民國 24.8	南韓 14.6	中華民國 17.2	新加坡 14.3	美國 19.0	日本 20.5
	4	美國 14.0	美國 10.6	美國 12.0	日本 8.3	美國 11.5	新加坡 11.8	新加坡 11.7
	5	新加坡 2.6	以色列 4.3	日本 5.6	新加坡 7.3	南韓 8.1	德國 6.1	馬來西亞 4.8
	6	以色列 1.8	日本 1.9	香港 4.7	荷蘭 6.2	中華民國 5.7	馬來西亞 3.3	德國 4.7

資料來源：Global Trade Atlas (GTA)、財政部統計處。

資料說明：生產半導體等機械係指 HS code 8486，金屬加工工具機係指 HS code 8456~8463。